

日月光一〇一年度第二季業績簡訊

日月光半導體於台灣時間 101 年 7 月 27 日同步於美國及台灣兩地發佈一〇一年度第二季獲利報告，本公司一〇一年度第二季之合併營業收入較一〇一年第一季成長 6%，較一〇〇年同期衰退 1%，為新台幣 45,872 百萬元。茲將日月光一〇一年度第二季單季之合併營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

簡明日月光集團合併營運分析表

單位：新台幣百萬元

項 目	101 年度 第二季	101 年度 第一季	100 年度 第二季	101 年度 上半年	100 年度 上半年
營業收入	45,872	43,101	46,254	88,973	92,259
營業毛利	8,857	7,188	8,964	16,045	17,622
營業淨利(淨損)	4,174	2,846	4,621	7,020	9,008
繼續營業部門稅前淨利(淨損)	3,738	2,583	4,749	6,321	9,845
所得稅利益(費用)	(442)	(465)	(998)	(907)	(1,961)
少數股權純損(益)	(94)	(62)	(107)	(156)	(266)
本期淨利(淨損)	3,202	2,056	3,644	5,258	7,618
稀釋每股盈餘(元)	0.48	0.31	0.54	0.78	1.12

簡明日月光半導體封裝測試營運分析表

單位：新台幣百萬元

項 目	101 年度 第二季	101 年度 第一季	100 年度 第二季	101 年度 上半年	100 年度 上半年
營業收入	32,485	29,236	32,255	61,721	63,134
營業毛利	7,288	5,656	7,533	12,944	14,628
營業淨利(淨損)	3,697	2,424	4,334	6,121	8,305
繼續營業部門稅前淨利(淨損)	3,539	2,423	4,580	5,962	9,355
所得稅利益(費用)	(310)	(356)	(832)	(666)	(1,478)
少數股權純損(益)	(27)	(11)	(104)	(38)	(259)
本期淨利(淨損)	3,202	2,056	3,644	5,258	7,618
稀釋每股盈餘(元)	0.48	0.31	0.54	0.78	1.12

半導體封裝測試營運

產 品 結 構	占營收比率(%)
通訊產品	50
個人電腦	13
汽車及消費性電子產品	36
其他	1
前十大客戶佔營收比重	47

銷 售 地 區	占營收比率(%)
北美	56
歐洲	12
台灣	20
日本	6
亞洲其他地區	6

封 裝 業 務 產 品 組 合	占營收比率(%)
Advanced Packaging	23
IC Wirebonding	69
Discrete and Others	8
封裝資本支出金額	283 百萬美元
打線機台數	14,669 台

測 試 業 務 產 品 組 合	占營收比率(%)
後段測試	82
晶圓測試	16
前段測試	2
測試資本支出金額	60 百萬美元
測試機台數	2,678 台

電子製造代工服務之產品結構及客戶組成

產 品 結 構	占營收比率(%)
通訊產品	32
電腦產品	24
消費產品	14
工業產品	20
汽車電子產品	9
其他	1
前十大客戶佔營收比重	80
EMS 資本支出金額	27 百萬美元